

强于大市

半导体行业周报

缺芯仍在持续，应用材料Epi、热处理、CMP、离子注入、量测等产品的全年收入增速均将超50%

半导体行业景气依然高企，下游需求火热，芯片交付时间超过20周，半导体设备交付期延长至14个月，汽车芯片短缺加剧，半导体整体性供需失衡。上周共有19家半导体公司发布年中报业绩，其中9家净利润同比涨幅超过100%。全球经济数字化和万物互联仍旧是半导体行业的发展主题，国产替代将驱动国内半导体企业全面成长。

行业动态：

- **中报业绩全线向好：**上周共有19家半导体企业披露2021上半年业绩报告，其中15家录得增长，9家取得净利同比翻番以上业绩，其余6家半导体企业均同比取得大幅度增长。集成电路持续高景气，其中晶丰明源净利同比增长3456.99%，士兰微净利同比增长1306.52%。从公司业绩变动的归因来看，多数企业业绩增长来自下游需求带动，预计行业将持续保持高景气。
- **目前共有99家半导体企业在IPO进程中，CIS芯片龙头格科微已于上周成功上市，普冉股份已于8月23日上市交易。**受累于发行人律师北京市天元律师事务所被中国证监会立案调查，比亚迪半导体与思特威IPO意外被中止审核，预计将在更换服务团队后申请恢复审核。半导体材料企业博蓝特在回复新一轮问询之后，主动撤销上市申请。
- **半导体设备：国际半导体设备龙头上半年营收高速增长，全球半导体市场将同比增长25.1%。**据WSTS全球半导体市场销售额最新预计，2021年全球半导体市场销售额将达5510亿美元，将显著增长25.1%，比前值上调4.5%，表明对下半年半导体市场景气继续高企持乐观态度。上周五美国应用材料公司公布上半年业绩，2021前两季度营收合计同比增长41%，而VLSI统计的2020全球前5的半导体设备公司中，ASML、LAM、KLA分别实现2021上半年营收同比增长45.4%、51%、29.5%，均实现高速增长，叠加设备龙头对下半年或全年收入指引的上修及众多设备订单交付期延长，预计半导体设备公司下半年营收或继续显著增长。
- **晶圆代工：MCU代工价格持续上涨，华润微上半年代工收入同比增长42.1%。**继MCU大厂新唐科技发布涨价函后，台联电传出今年以来第四季度价格调涨的消息。国内功率半导体龙头华润微上半年实现营收44.6亿元，同比增长45.4%，而其对外代工方面实现销售收入23.8亿元，与去年同期相比增长42.1%。随着成熟制程供需紧缺仍未获得缓解，叠加马来西亚疫情失控及Delta病毒的持续影响，台积电等多家代工厂上调晶圆代工价格，下半年晶圆代工厂的营收仍值得期待。
- **芯片：汽车缺芯没有看到明显的缓解迹象。**因Delta病毒肆虐全球，多家芯片供应商工厂关闭生产线，全球车用芯片供应商博世ESP/IPB、VCU和TCU等芯片受到马来西亚生产线关闭的影响，预计8月后期将基本处于断供状态。中国市场的复苏进一步推动了需求的增长，使得情况变得更加严峻，一些汽车生产或面临中断的风险。德国汽车工业协会(VDA)日前表示，受缺芯影响，2021年德国的汽车产量预计将减少40万辆，全球汽车产量预计将被迫削减400万辆，预计全球汽车行业因芯片短缺导致的损失高达1100亿美元。
- **半导体材料：三星、SK海力士应用国产半导体材料。**因日本对韩半导体材料出口限制，出于降低供应链风险的考虑，三星电子正在测试一家韩国公司制造的EUV光刻胶。据报道，三星下半年可能会采用该材料生产12nm技术节点的DRAM。同时，SK海力士也在与韩国氢氟酸制造商RAM Technology合作，以减少对进口氟化氢的依赖。

投资建议：

- **设备组合：**中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份；建议关注：晶盛机电、光力科技、神工股份。
- **材料组合建议关注：**沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份
- **功率半导体组合：**新洁能、华润微；建议关注：斯达半导、士兰微、闻泰科技
- **模拟建议关注：**圣邦股份、思瑞浦、卓胜微（射频）
- **MCU：**兆易创新；建议关注中颖电子
- **其他：**韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

风险提示

- 疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；半导体材料国内市场增速放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

相关研究报告

《半导体行业周报：全球半导体设备交付期延长至14个月》20210817

《盛美半导体（ACMR）21Q2业绩点评及电话会议纪要：坚定技术差异化、产品平台化、客户国际化战略，让客户从公司产品、技术中受益》20210813

《半导体新股系列8-格科微（688728）：全球CIS龙头，拟自建2万片/月12英寸BSI晶圆后道工序》20210811

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

电子：半导体

证券分析师：杨绍辉

(8621)20328569
shaohui.yang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：余媛媛

(8621)20328550
yuanyuan.yu@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

证券分析师：王达婷

(8621)20328284
dating.wang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300519060001

目录

半导体企业 2021 上半年业绩报告汇总.....	4
拟 IPO 的半导体企业汇总	6
行业数据回顾	9
上周信息汇总	13
IP & EDA.....	13
半导体设备	13
半导体材料	13
晶圆代工	14
封测	14
功率半导体	15
射频芯片	15
MCU	15
风险提示.....	16

图表目录

图表 1. 上周 2021 上半年半导体企业业绩公告统计表.....	4
续图表 1. 上周 2021 上半年半导体企业业绩公告统计表.....	5
图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/22)	6
续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/22)	7
续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/22)	8
图表 3. 全球半导体销售额当月值.....	9
图表 4. 北美半导体设备制造商出货额:当月值 (百万美元)	9
图表 5. 日本半导体设备制造商出货额:当月值 (百万美元)	10
图表 6. 美国与国内半导体指数对比	10
图表 7. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (美元)	10
图表 8. 美国与国内半导体指数对比(近十周涨跌幅)	10
图表 9. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (美元)	10
图表 10. 申万半导体材料指数.....	11
图表 11. 全球半导体级硅片出货量	11
图表 12. 半导体器件封装材料进出口金额.....	12
图表 13. 半导体器件封装材料进出口单价.....	12
图表 14. 上周半导体行业涨跌幅前五个股.....	12

半导体企业 2021 上半年业绩报告汇总

截止 2021/8/22，半导体行业下游需求旺盛，企业盈利能力大幅提升。上周共有 19 家半导体企业披露 2021 上半年业绩报告，其中 15 家录得增长，9 家取得净利同比翻番以上业绩，其余 6 家半导体企业均同比取得大幅度增长。集成电路持续高景气，其中晶丰明源净利同比增长 3456.99%，士兰微净利同比增长 1306.52%。从公司业绩变动的归因来看，多数企业业绩增长来自下游需求带动，预计行业将持续保持高景气。

图表 1. 上周 2021 上半年半导体企业业绩公告统计表

序号	类别	证券代码	证券简称	归属于上市公司股东净利润	同比增长 (%)	业绩变动归因	披露时间
1	材料	603688.SH	石英股份	1.13 亿	(7.13)	产能扩张，固定资产规模进一步扩大，每年新增折旧费用将在一定程度上影响公司的净利润	2021/8/21
2	材料	300236.SZ	上海新阳	1.08 亿	316.82	主要是报告期内公司晶圆制造用电镀液及清洗液等超纯化学产品营业收入大幅增长	2021/8/20
3	材料	688268.SH	华特气体	6587 万	53.79	主要系国内半导体特气需求大增、民用气体销量增长、以及新产品和客户开拓所致	2021/8/20
4	材料	603931.SH	格林达	6258.59 万	20.92	产销持续释放贡献业绩，原料价格下降增厚毛利	2021/8/20
5	材料	002916.SZ	深南电路	5.61 亿	(22.57)	在产业供给端，大宗商品、原材料、芯片及各类电子元器件的供应短缺与涨价成为普遍现象；在产业需求端，疫情经济驱动的需求分化仍在持续，通信行业需求有所后延	2021/8/20
6	材料	300054.SZ	鼎龙股份	9141 万	(54.1)	上年同期，因深圳超俊原股东重大资产重组的业绩承诺未完成而对上市公司补偿收入为 1.25 亿元，由此导致上市公司上年同期净利润增加 1.06 亿元。	2021/8/19
7	集成电路	600584.SH	长电科技	13.22 亿	260.97	主要系近年来公司聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用，以及与之对应的国际和国内的重点客户订单强劲需求。同时，国内外各工厂持续加大运营管理能力的提升，积极调整技术和产品结构，进而持续推动盈利能力提升。 "1) 公司下游订单需求盛，销售收入同比快速增长，主要来自于 AMOLED 显示驱动芯片及锂电池管理芯片的倍数级增长 2) 从利润端来看，2021 年公司归母净利润同比增长 62.6%，公司毛利率为 44.5%，较去年同期增加 4.3pp，主要受益于锂电管理品类 (TWS) 及份额提升以及 MCU 涨价变动影响，公司毛利率同比提升；净利率为 22.2%，较去年同期增长 2.8pp 3) 从费用端来看，公司销售费用率为 1.7%，同比下降 1pp；管理费用率为 3.7%，同比下降 0.8pp；研发费用率为 17%，同比上升 0.8pp。"	2021/8/21
8	集成电路	300327.SZ	中颖电子	1.53 亿	62.62		2021/8/20
9	集成电路	300458.SZ	全志科技	2.42 亿	181.44	主要得益于在智能家电/智能扫地机/智能视觉/智能车载/智能音箱等场景中，公司与一系列标杆客户协同推进产品智能化应用，智能硬件、智能车载等产品线持续放量，带动业绩高速增长。	2021/8/20
10	集成电路	688286.SH	敏芯股份	1021.77 万	(40.05)	主要原因系本期新增股份支付所致。如剔除股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 2,580.13 万元和 2,055.61 万元，比去年同期增长 51.39% 和 29.15%；剔除股份支付影响后盈利大幅上升主要系公司收入规模增长提升所致。	2021/8/20

资料来源：公司公告、中银证券

续图表 1. 上周 2021 上半年半导体企业业绩公告统计表

序号	类别	证券代码	证券简称	归属于上市公司股东净利润	同比增长 (%)	业绩变动归因	披露时间
11	集成电路	688396.SH	华润微	10.68 亿	164.86	整体受益于半导体高景气度及国产替代大趋势，产能利用率处在高位和服务和产品价格调涨，整体订单饱满，各事业群营业收入均有所增长。	2021/8/19
12	集成电路	688368.SH	晶丰明源	3.36 亿元	3456.99	在销售数量方面，公司所处行业下游需求旺盛。在产品单价方面，由于上游原材料价格提升，为了平衡产品成本与客户需求等因素，公司对产品价格进行了调整，单价提升带动产品综合毛利率由上年同期 25.03% 增加至 46.76%，增加 21.73 个百分点；在产品结构方面，由于行业上游产能供应仍处于紧张状态且短期内暂未出现缓解现象，2021 年上半年，公司对产品结构进行了优化，提高了智能 LED 照明驱动芯片的交付优先级，公司智能 LED 电源驱动芯片占整体销售收入比例由上年同期 36.91% 增加至 44.33%。	2021/8/18
13	集成电路	600460.SH	士兰微	4.31 亿	1306.52	主要是因为：1、公司 8 寸芯片生产线保持较高水平的产出，芯片产量有较大幅度的增长，产品综合毛利率提高至 18.35%。2、LED 芯片生产线基本处于满负荷生产状态，产品综合毛利率提高至 6.87%。3、集成电路和分立器件产品销量较去年同期大幅度增长，产品毛利率提高至 23.94%。	2021/8/17
14	集成电路	688099.SH	晶晨股份	1.6 亿	-	规模效应下公司盈利能力大幅提升。2021H1 公司毛利率为 36.23%，同比+7.65pct，环比+1.07pct；净利润率为 12.44%，同比+19.09pct，环比+2.57pct。期间费用方面，销售费用率为 1.82%，管理费用率为 2.41%，财务费用率为 0.35%，销售费用率和管理费用率相比同期均有减少。	2021/8/17
15	集成电路	688123.SH	聚辰股份	6575.22 万元	41.23	下游终端应用市场需求逐步回暖，为了将公司毛利率稳定在较高水平，公司自 2021 年起适当调整了 EEPROM 等主要产品的价格体系。受此影响，公司综合毛利率连续两个季度实现环比增长，其中 2021 年第二季度环比提升 1.82 个百分点，2021 年第一季度环比提升 2.25 个百分点。	2021/8/16
16	分立器件	300373.SZ	扬杰科技	3.44 亿	138.57	公司不断丰富产品线，拓展高可靠性产品规格和高能效产品系列，持续向高端转型；2021H1 销售毛利率达 34.06%，继续保持高位。报告期内公司费用把控优秀，销售和管理费用分别同比下降 2.06 和 2.17 个 pct。	2021/8/20
17	分立器件	300623.SZ	捷捷微电	2.40 亿	105.21	受益于行业高景气、功率器件国产替代加速，以及公司产品结构优化升级、IPO 募投项目边际效应持续发挥，公司业绩实现快速增长	2021/8/20
18	分立器件	688689.SH	银河微电	5784.61 万	88.39	市场需求旺盛，扩大了小信号器件、功率器件、光电器件产品的品种和产能，提高了生产效率和产品良率。	2021/8/20
19	半导体设备	688630.SH	芯碁微装	4315.58 万	335.34%	新产品新应用驱动 PCB 行业不断增长，国内 PCB 市场占有率不断提升，产业向国内转移趋势明显，直接成像设备替代现有传统曝光设备需求强劲。	2021/8/19

资料来源：公司公告、中银证券

拟 IPO 的半导体企业汇总

截止 2021/8/22，共有 99 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等。上周 CIS 芯片龙头格科微于科创板上市，普冉股份将于 8 月 23 日上市交易；受累于发行人律师北京市天元律师事务所被中国证监会立案调查，比亚迪半导体与思特威 IPO 意外被中止审核，预计将在更换服务团队后申请恢复审核。半导体材料企业博蓝特在回复新一轮问询之后，主动撤销上市申请。

图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/22)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
1	中车电气	已注册	中金公司	2005	设计	功率半导体
2	宏微科技	已注册	民生证券	2006	设计	以 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组
3	雷电微力	已注册	中信证券	2007	设计	高性能微波及射频 SOC 集成电路
4	盛美股份	已注册	海通证券	2005	设备	清洗设备、FN、镀铜设备等
5	华海清科	提交注册	国泰君安	2013	设备	CMP 设备
6	灿勤科技	提交注册	中信建投	2004	设计	微波介质陶瓷元器件
7	炬芯科技	提交注册	申万宏源	2014	设计	蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等
8	东芯股份	提交注册	海通证券	2014	设计	24nm NAND、48nm NOR
9	【苏州】国芯科技	提交注册	国泰君安	2001	设计	国产自主 32 位高性能嵌入式 CPU 开发、嵌入式产品设计和应用
10	安路科技	提交注册	中金公司	2011	设计	可编程逻辑器件 (FPGA)、可编程系统级芯片 (SoC)、及相关 EDA 软件工具和创新系统解决方案
11	翱捷科技	提交注册	海通证券	2015	设计	全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片
12	创耀科技	过会	海通证券	2006	设计	通信芯片
13	云天励飞	过会	中信证券	2014	设计	AI 芯片
14	芯龙半导体	问询	海通证券	2007	设计	电源管理类模拟集成电路
15	芯导科技	问询	国元证券	2009	设计	功率
16	华卓精科	问询	东兴证券	2012	零部件	光刻机双工件台
17	中图科技	问询	申万宏源	2013	材料	图形化蓝宝石衬底
18	屹唐股份	问询	国泰君安、中金公司	2015	设备	刻蚀、去胶、退火
19	希荻微	问询	民生证券、中金公司	2012	设计	高性能模拟集成电路
20	芯微电子	问询	国元证券	2009	设计	功率半导体
21	英集芯科技	问询	华泰联合	2014	设计	数模混合集成电路芯片
22	江波龙	问询	中信建投	1999	设计	嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储、汽车存储等
23	东微半导体	问询	中金公司	2008	设计	高性能功率器件
24	莱特光电	问询	中信证券	2010	材料	OLED 有机材料
25	华大九天	问询	中信证券	2009	软件	EDA 软件
26	唯捷创芯	问询	中信建投	2010	设计	射频前端及高端模拟芯片
27	龙芯中科	问询	中信证券	2010	设计	CPU
28	天岳先进	问询	海通证券	2010	材料	半绝缘型和导电型碳化硅衬底
29	纳芯微	问询	光大证券	2013	设计	车规级传感器及信号链芯片
30	晶合集成	问询	中金公司	2015	设计	面板驱动芯片
31	必易微	问询	申万宏源	2009	设计	高性能模拟及混合信号集成电路
32	长光华芯	问询	华泰联合	2012	设计	高功率半导体激光器芯片等
33	炬光科技	问询	中信建投	2007	设计	高功率半导体激光器及微光学相关产品
34	思科瑞	问询	中国银河证券	2014	测试	分立器件及晶圆测试
35	麦斯克	问询	国泰君安	1995	材料	硅片
36	甬矽电子	问询	平安证券	2019	封测	封测
37	比亚迪半导体 (其他事项)	中止	中金公司	2004	设计	功率半导体
38	赛微微	问询	国泰君安	2009	设计	电源管理芯片

资料来源：上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/22)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
39	概伦电子	问询	招商证券	2010	软件	EDA 软件
40	中微股份 (深圳)	问询	中信证券	2001	设计	混合信号 SoC
41	龙腾半导体	问询	国信证券	2009	设计	新型功率半导体器件
42	盛景微	问询	光大证券	2016	设计	物联网控制芯片
43	臻镭科技	问询	中信证券	2015	设计	射频芯片、电源管理芯片
44	思特威	中止(其他事项)	中信建投	2011	设计	CMOS 图像传感器芯片
45	天德钰	问询	中信证券	2010	设计	智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案
46	奥比中光	问询	中信建投	2013	设计	深度引擎数字芯片、专用感光模拟芯片
47	好达电子	问询	安信证券	1999	设计	SAW Filter
48	烨映微	问询	海通证券	2016	设计	MEMS 非制冷热电堆红外传感器
49	沈阳拓荆	问询	招商证券	2010	设备	薄膜沉积设备
50	峰岷科技	问询	海通证券	2010	设计	电机驱动控制芯片
51	广立微	问询	中金公司	2003	软件/设备	EDA 软件、电路 IP、晶圆级电性测试设备
52	上海微	问询		2002	设备	光刻机
53	毓昌科技	已申报	国信证券	2010	设计	微波毫米波射频芯片
54	金海通	已申报	海通证券	2012	设备	高温 IC 自动测试 Pick-Place 分选机
55	路维光电	已申报	国信证券	2012	材料	掩模板
56	国博电子	完成上市辅导	招商证券	2010	设计	射频
57	艾森半导体	完成上市辅导	华泰联合	2010	材料	光刻胶及配套高纯化学品
58	国微思尔芯	完成上市辅导	中金公司	2003	软件	EDA
59	江苏影速	上市辅导	中金公司	2014	设备	激光直写的光刻机设备
60	矽电半导体	上市辅导	招商证券	2003	设备	探针台
61	中科飞测	上市辅导	国泰君安	2014	设备	量测设备
62	海光信息	上市辅导	中信证券	2014	设计	CPU
63	苏州赛芯微	上市辅导	国泰君安	2009	设计	模拟芯片
64	耐科装备	上市辅导	国元证券	2005	设备	半导体封装装备
65	上海伟测	上市辅导	平安证券	2016	测试	晶圆测试和芯片成品测试
66	芯动联科	上市辅导	中信建投	2012	设计	MEMS
67	芯微电子	上市辅导	国金证券	1998	设计	功率半导体分立器件
68	禹龙通	上市辅导	招商证券	2005	设计	大功率射频电阻, 同轴负载、衰减器、波导系列无源器件、碳化硅及橡胶板吸波材料
69	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	设计	单、双向晶闸管全系列, 低频功率三极管、单、双向 TVS 保护管、双向(防静电)放电管
70	富创精密	上市辅导	中信证券	2008	零部件	半导体设备精密零部件加工制造及表面处理
71	源杰半导体	上市辅导	国泰君安	2013	设计	激光器芯片
72	【杭州】国芯科技	上市辅导	中信证券	2001	设计	数字电视芯片、面向物联网人工智能芯片
73	新顺微电子	上市辅导	华泰联合	2002	设计	功率半导体
74	微源半导体	上市辅导	海通证券	2010	设计	电源管理芯片
75	南麟电子	上市辅导	国金证券	2004	设计	模拟和数模混合类集成电路的设计与研究
76	芯天下	上市辅导	中信建投	2014	设计	NOR Flash
77	灿芯半导体	上市辅导	海通证券	2008	软件	定制化芯片(ASIC) 设计方案提供商及 IP 供应商
78	杰华特	上市辅导	中信证券	2013	设计	电源管理芯片
79	安凯微电子	上市辅导	东方证券	2000	设计	物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片
80	易兆微	上市辅导	海通证券	2014	设计	短距离无线通讯芯片
81	辉芒微	上市辅导	中信证券	2005	设计	专注于非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片
82	飞驒科技	上市辅导	中金公司	2015	设计	射频芯片
83	通美晶体	上市辅导	海通证券	1998	材料	砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/22)

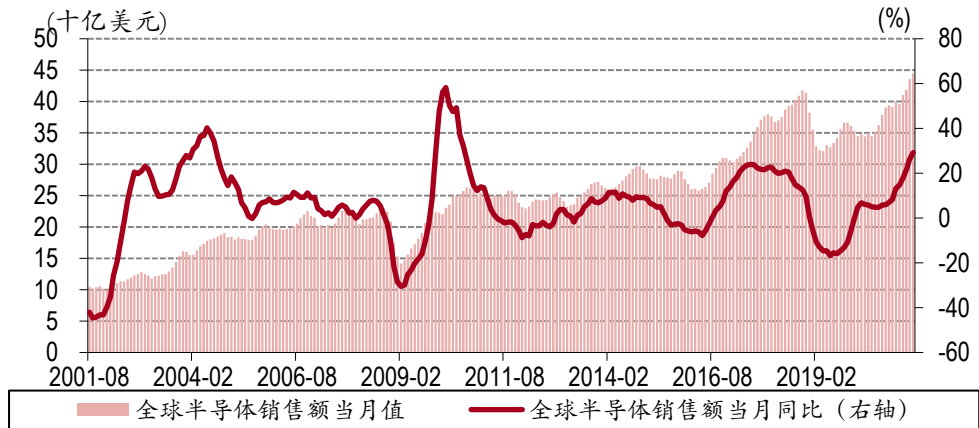
序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
84	蕊源半导体	上市辅导	中金公司	2016	设计	电源管理
85	上海超硅	上市辅导	中金公司	2008	材料	大硅片
86	汇成真空	上市辅导	东莞证券	2006	设备	真空应用设备
87	中巨芯	上市辅导	海通证券	2017	材料	电子湿化学品、电子特种气体、半导体前驱体
88	锐成芯微	上市辅导	华泰联合	2011	软件	IP 授权
89	新恒汇电子	上市辅导	平安证券	2017	封测/材料	晶圆测试减划、封装材料高精度蚀刻金属引线框架、物联网 eSIM 封装
90	映日科技	上市辅导	安信证券	2015	材料	靶材
91	绍兴中芯	上市辅导	海通证券	2018	代工	专注于功率、传感和传输应用, 特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工服务的制造商
92	有研半导体	上市辅导	中信证券	2001	材料	硅片
93	京仪装备	上市辅导	国泰君安	2016	设备	半导体温控装置系列 (Chiller)
94	盛科通信	上市辅导	中金公司	2019	设计	以太网交换芯片
95	思必驰	上市辅导	中信证券	2007	设计	AI 芯片
96	欣盛半导体	上市辅导	中信建投	2016	IDM	COF 封装显示驱动芯片
97	振华风光	上市辅导	中信证券	2005	IDM	高可靠半导体模拟集成电路
98	兴福电子	上市辅导		2008	材料	电子级磷酸、电子级硫酸、蚀刻液、剥膜液、显影液、光阻稀释剂、清洗液、再生剂等湿电子化学品
99	蓝箭电子	上市辅导	金元证券	1998	封测	封装的双极型晶体管、场效应晶体管、集成电路 (IC)、LED 及 LED 照明灯具

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

行业数据回顾

6月全球半导体销售额达445.3亿美元，同比增长29.2%。根据美国半导体产业协会数据，6月全球半导体销售额继续保持增长，较5月增长2.1%，2021年1-6月全球半导体销售额增长13.71%。

图表 3. 全球半导体销售额当月值



资料来源：万得，美国半导体产业协会，中银证券

6月北美半导体设备出货金额36.7亿美元，连续六个月创新高。据SEMI统计，6月北美半导体设备出货金额继续创新高，较5月的35.9亿美元提升2.3%，较2020年同期23.2亿美元上升58.4%。2021年1-6月份出货额的环比增幅分别为13.3%、3.5%、4.2%、4.7%、4.7%、2.3%。

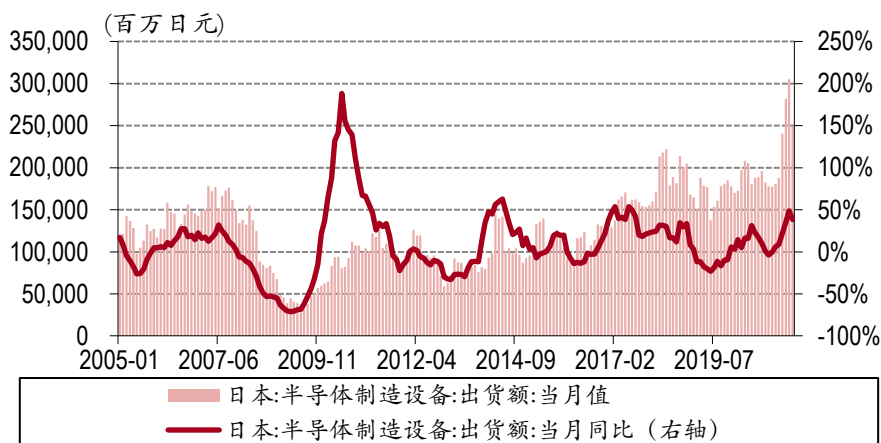
图表 4. 北美半导体设备制造商出货额:当月值 (百万美元)



资料来源：万得，SEMI，中银证券

6月日本半导体设备出货金额2495亿日元，同比增长38%。据日本半导体制造装置协会统计，6月日本半导体设备出货金额有所回落，较5月的3054亿日元下降18.3%，相比于2020年同期1804亿日元仍上升38%。2021年1-6月份出货额的环比增幅分别为1.9%、3.7%、28.4%、17.2%、8.3%、-18.3%。

图表 5. 日本半导体设备制造商出货额: 当月值 (百万美元)



资料来源: 万得, 日本半导体制造装置协会, 中银证券

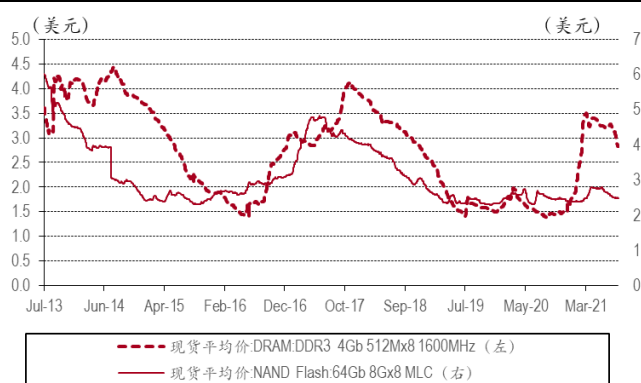
国内国外半导体指数涨跌不一, 存储周度价格小幅下降。近一周申万行业半导体指数报 6598.24, 微涨 0.59%, 保持在历史高位水平。费城半导体指数则有所下滑, 收报 3256.5 点, 下跌 2.35%。近一周存储现货平均价较前期继续下行, NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC 价格连续下滑并在上周下跌 0.3%, DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz 价格较上周下跌 1.9%, 连续第 6 周录得下跌。

图表 6. 美国与国内半导体指数对比



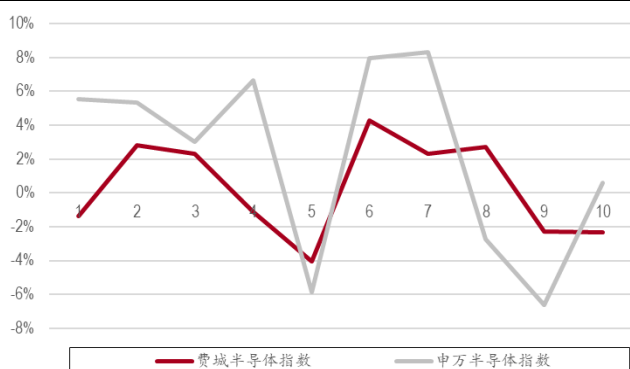
资料来源: 万得, 中银证券

图表 7. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (美元)



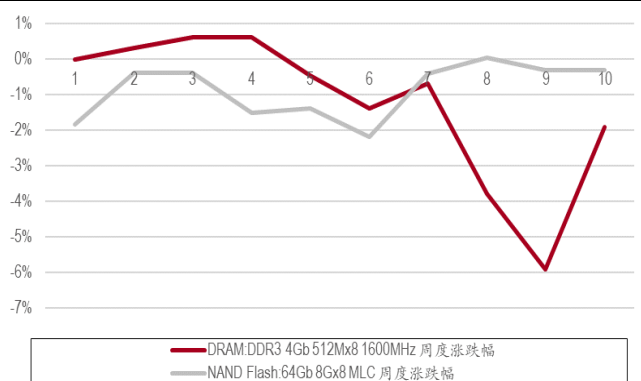
资料来源: 万得, 中银证券

图表 8. 美国与国内半导体指数对比(近十周涨跌幅)



资料来源: 万得, 中银证券

图表 9. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (美元)



资料来源: 万得, 中银证券

上周申万半导体材料指数收报 10506.31 点, 较上周上涨 1.68%。年初至今, 申万半导体材料指数已上涨 74.56%, 7 月 30 日达到近期峰值 12438 点, 进入 8 月后指数略有下调或逐步进入调整期。

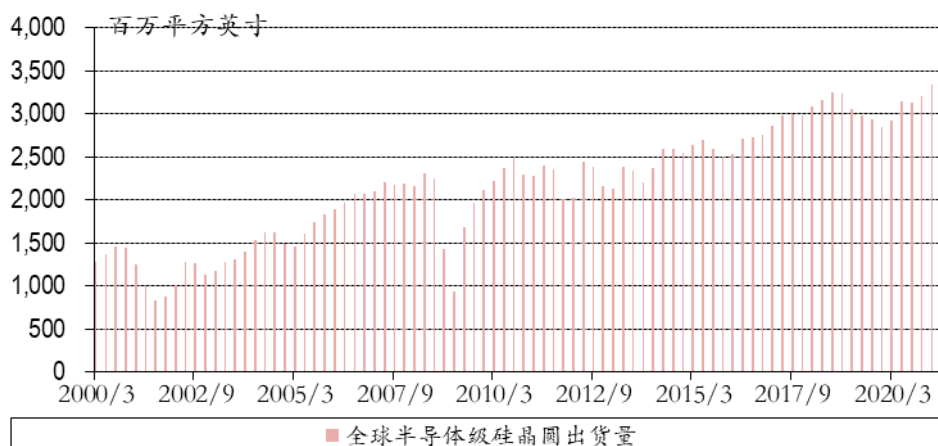
图表 10. 申万半导体材料指数



资料来源: 万得, SEMI, 中银证券

硅晶圆: 根据 SEMI 数据, 2021 年第二季度全球半导体级硅晶圆出货量达 3534 百万平方英寸, 同比增长 12.1%, 全球半导体级硅晶圆出货量屡创新高。

图表 11. 全球半导体级硅片出货量



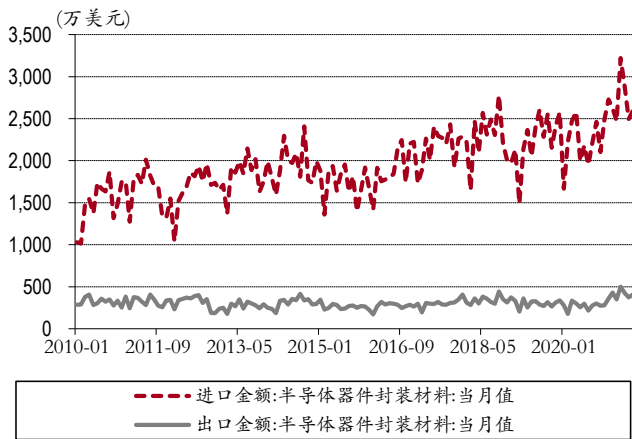
资料来源: SEMI, 中银证券

光刻胶: 光刻胶国产化进程仍在推进, 根据上海新阳 2021 半年度报告, 公司自主研发的 KrF 光刻胶产品已通过客户认证, KrF 光刻胶已取得 2 家客户订单, ArF 干法光刻胶尚在认证当中。目前国内缺乏 ArF 光刻胶规模量产经验, 产品配套产业链上的诸多技术难点需要公司技术部门自主攻关, 解决技术和工艺瓶颈。后续需关注国产 ArF 光刻胶订单情况。

湿电子化学品: 国内湿电子化学品进入产能集中扩张期, 日前, 怡达股份在投资者互动平台上表示珠海怡达 3 万吨湿电子化学品 (Thinner 液) 混配及洁净灌装技术改造项目已经建成, 目前正在进行验收审核工作。

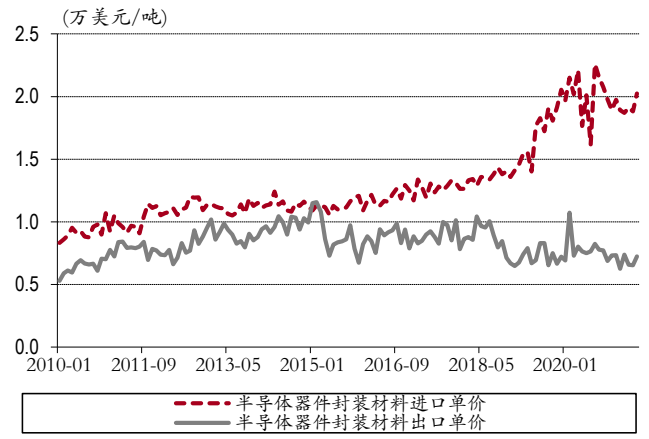
封装材料: 鼎龙股份 2021 年半年度报告显示, 抛光垫产品营收同比增长近 4 倍, 其中二季度产品营收环比上涨超过 50%, 产品净利润较去年同期扭亏为盈。同时, 公司 7 月份抛光垫销量首次单月突破 1 万片, 12 寸产品占比超过 80%, 公司在抛光垫领域国内市场优势初步确立。

图表 12. 半导体器件封装材料进出口金额



资料来源: 万得、海关总署、中银证券

图表 13. 半导体器件封装材料进出口单价



资料来源: 万得、海关总署、中银证券

图表 14. 上周半导体行业涨跌幅前五个股

代码	简称	涨幅 (%)	代码	简称	跌幅 (%)
300724.SZ	捷佳伟创	35.70	688123.SH	聚辰股份	(17.58)
002610.SZ	爱康科技	34.19	688589.SH	力合微	(16.77)
300708.SZ	聚灿光电	19.31	300139.SZ	晓程科技	(13.73)
688699.SH	明微电子	14.42	300831.SZ	派瑞股份	(13.56)
002049.SZ	紫光国微	12.57	300393.SZ	中来股份	(13.25)

资料来源: 万得, 中银证券

上周信息汇总

IP & EDA

【概伦电子】概伦电子称EDA产品打破市场垄断格局

中证报8月20日讯，概伦电子表示公司打破了电路仿真及验证EDA工具市场高度垄断格局，在全球存储器芯片领域取得较强的竞争优势，得到全球领先存储器芯片厂商的广泛使用。公司器件建模及验证EDA工具在全球范围市场地位较为稳固，得到全球领先晶圆厂的广泛使用，包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等全球前10大晶圆代工厂中的9家。报告期内，来自上述9家晶圆代工厂的器件建模及验证EDA工具收入占公司制造类EDA工具的累计收入比例超过50%。

(资料来源：中证报)

【芯和半导体】芯和半导体发布高速仿真EDA 2021版本

TechWeb 8月19日消息，芯和半导体在美国圣何塞举行的2021年DesignCon大会上，正式发布其高速仿真EDA解决方案2021版本。芯和半导体高速仿真EDA 2021版本最大的特色——在针对“2.5D/3DIC先进封装”设计的电磁场(EM)仿真工具Metis中采用了突破性的加速矩量法(MoM)求解器。新的求解器在确保精度无损的情况下，提供了前所未有的速度和内存表现。它首创了“速度-平衡-精度”三种仿真模式，帮助工程师根据自己的应用场景选择最佳的模式，以实现仿真速度和精度的权衡。

(资料来源：TechWeb)

半导体设备

【行业】半导体设备公司亮眼的上半年成绩单

证券之星8月20日讯，稳坐全球半导体设备的前十名的赢家，还是如下这几家：应用材料(Applied Materials)、阿斯麦(ASML)、泛林(LAM Research)、东京电子(Tokyo Electron Limited (TEL))、科磊半导体(KLA-Tencor)、爱德万(Advantest)、斯科半导体(SCREEN)、泰瑞达(Teradyne)、日立高新(Hitachi High-Tech)、先进太平洋科技(ASM Pacific Technology)等。所有的设备企业无一例外上半年比去年同期都收获了不同程度的增长，40%-50%的增幅很常见。

(资料来源：证券之星)

半导体材料

【东尼电子】东尼电子经营范围拟增加“碳化硅半导体材料的生产”等

智通财经讯，东尼电子公告，公司董事会于2021年8月20日审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意增加经营范围：碳化硅半导体材料、节能型太阳能胶膜、线路板的生产。

(资料来源：智通财经)

【行业】降低供应链风险，三星、SK海力士应用本国产半导体材料

《科创板日报》8月20日讯，据BusinessKorea报道，三星电子正在测试一家韩国公司制造的EUV光刻胶。据称，三星电子下半年可能会采用该材料生产14nm技术节点的DRAM。与此同时，SK海力士也在与韩国氢氟酸制造商RAM Technology合作，以减少对进口氟化氢的依赖。

(资料来源：科创板日报)

【鼎龙股份】CMP 抛光垫持续加速放量，光电半导体材料多点布局

创业板 8 月 20 日讯，CMP 抛光垫持续快速放量，国产化龙头分享国内晶圆产能大扩张红利。清洗液、PI 浆料放量在即，布局半导体先进封装材料市场，光电半导体材料业务多点布局。同时公司 PSPI、INK 产品均在客户端测试顺利推进中。

(资料来源：创业板)

晶圆代工

【行业】MCU 晶圆代工价格将上调，13 只概念股半年报业绩翻番

证券时报 8 月 20 日讯，全球成熟制程产能严重短缺之下，晶圆代工价格再次迎来调涨。据行业消息，8 月 12 日台湾 MCU（微控制器）大厂新唐科技发布涨价函。该涨价函表示，由于今年第三季度的晶圆继续供不应求，产能失调，新唐科技将于 9 月 1 日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高 15%。截至 8 月 19 日，MCU 概念股中有 16 只已发布或预告半年报业绩，且均实现同比 50% 以上增长，13 只概念股业绩增幅超 100%。

(资料来源：证券时报)

【赛微电子】赛微电子：公司全资子公司瑞典 Silex Microsystems AB 在全球 MEMS 纯晶圆代工排名中继续位居第一

赛微电子 8 月 18 日在投资者互动平台表示根据半导体市场研究机构 Yole Development 统计的 2020 年数据，公司全资子公司瑞典 Silex Microsystems AB 在全球 MEMS 纯晶圆代工排名中继续位居第一，第二至第五名仍然为 TELEDYNE DALSA、索尼（SONY）、台积电（TSMC）和 X-FAB。2020 年公司在全球 MEMS 芯片代工市场（不包含 IDM 厂商自身制造部分的统计）的占有率约为 8%。

(资料来源：每日经济新闻)

封测

【长电科技】并购“阴影”消散，产品需求火爆，封测龙头长电科技上半年净利同比增 2.6 倍

8 月 20 日，长电科技发布半年报。今年上半年，长电科技实现营业收入 138.19 亿元，同比增长 15.39%，归母净利润 13.22 亿元，同比增长 260.97%。长电科技表示，业绩的高速增长源于客户订单需求强劲以及整合资源调整技术、产品结构。

(资料来源：每日经济新闻)

【行业】海外再传“封测厂关闭”消息，通富微电等国内龙头积极扩产

全球“缺芯”依旧持续，近日又传来“马来西亚疫情加重！传意法半导体封测厂关闭”的消息。华创证券发布的研报显示，在海外疫情二次爆发的背景下，海外供给恢复滞后于海外需求恢复，溢出效应导致大中华地区代工产能供需两旺。在马来西亚汽车电子等封测产能受限的情况下，国内封测龙头也有望获取更多的溢出订单。业内人士分析称，相关封测企业不排除再次涨价的可能性。

(资料来源：e 公司)

功率半导体

【华润微】公司上半年营收同比增长四成半，扩大布局功率半导体制造与封测

8月18日，IDM厂商华润微发布2021年半年度报告。报告显示，2021年上半年，华润微实现营业收入44.55亿元，较上年同期增长45.43%；实现归属于母公司所有者的净利润10.68亿元，较上年同期增长164.86%。封装测试方面，报告期内，智能功率模块封装处于满产状态，客户需求持续增加，公司将与客户共同开发新型IPM封装产品，未来公司将会形成更加丰富的IPM封装平台。

（资料来源：中国电子报）

【长光华芯】在高功率半导体激光芯片领域居于国内领先地位

发布易8月16日讯，长光华芯表示，在高功率半导体激光芯片领域，公司的国内市场占有率排第一，居于国内领先地位。

此次，公司募集资金拟用于高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目，垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)及光通信激光芯片产业化项目，研发中心建设项目以及补充流动资金。

（资料来源：发布易）

射频芯片

【派格测控】射频前端芯片测试方案提供商“派格测控”完成数千万元A轮融资

36氪8月18日获悉，射频前端芯片测试方案提供商“派格测控”于本月完成由架桥资本领投的数千万元A轮融资。据派格测控CEO李翔透露，此轮融资主要用于研发投入、市场推广和团队扩充。

（资料来源：36氪）

【和而泰】国内智能控制器中军民用市场稀缺的射频芯片龙头

新浪8月16日讯，和而泰是国内智能控制器龙头企业，在家电、电动工具领域份额持续提升，并成功切入汽车ECU市场，成长曲线清晰。此外，公司通过收购进军毫米波T/R芯片领域，是A股稀缺的射频芯片设计企业，未来有望在军民市场占据核心地位。

（资料来源：36氪）

MCU

【行业】汽车MCU芯片缺货难缓解车企开启自救模式

8月20号，《中国经营报》记者从博世方面了解到，尽管博世德累斯顿的工厂已于6月份投入运营，但也无法解决半导体整体性短缺。“在当前紧张的情况下，博世一直与客户和供应商一起全天候工作，全力以赴地保持交付。”与此同时，国内MCU芯片厂商迎来一大发展契机，相关制造厂商如雨后春笋般出现，国内外不少车企也开始向国产MCU芯片厂商采购。

而伴随着汽车芯片供应紧张而来的，还有芯片价格上涨的消息。“一芯难求”成为各整车厂亟待解决的难题，根据7月产销统计，广汽集团多个合资车企当月产销出现了环比下滑，主要原因即是缺芯。

（资料来源：中国经营报）

风险提示

疫情影响超预期：新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

半导体设备国产化进程放缓：新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

半导体材料国内市场增速放缓：半导体材料从世界范围来看是个增速较为缓慢的市场，中国市场在过去5年中CAGR达到了10%，远高于世界平均水平。若半导体材料进入下行周期，目前国内市场的增速将难以持续。

美国进一步向中国禁售关键半导体设备：由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20% 以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在 -10%-10% 之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10% 以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371